****

***【プレスリリース】***

2021年3月1日

報道関係各位

\*本プレスリリースは、[独congatec AGが、2021年2月18日（現地時間）、ドイツで発表したプレスリリース](https://www.congatec.com/jp/congatec/press-releases/article/congatec-to-solve-ruggedization-challenges-of-edge-server-and-client-designs/)の抄訳です。

**コンガテック、embedded world 2021 DIGITALに出展**

**高性能のCOM-HPCから低消費電力のSMARCまで、拡張温度に対応**

**エッジコンピューティング用に設計・最適化された製品ファミリー**

**

高性能組込みコンピューティング製品のリーディングサプライヤである[congatec（コンガテック）](http://www.congatec.jp/)は、3月１日～５日（現地時間）、本年はオンラインにて開催される「[embedded world 2021 DIGITAL](https://www.embedded-world.de/en)」に出展します。コンガテックのブースでは、近年ますます顧客要求の高まる「製品の頑強性」を主要なテーマに掲げ、ハイエンド製品であるCOM-HPCから低消費電力のSMARCモジュールまで、あらゆるパフォーマンスレベルに対応する拡張温度範囲プラットフォームを展示します。とりわけ注目されるのは、COM-HPCサーバ・モジュール向けのソリューションポートフォリオです。現在、エッジコンピューティング・プラットフォーム向け製品には極めて高い熱設計電力（TDP）が要求され、特に拡張温度範囲において非常に困難なタスクとなっていますが、今回コンガテックが出展するポートフォリオは、こうした開発者の課題に正面から応えるものです。

この背景には、極めて過酷な環境下での導入が進められることも多いデジタル化プロジェクトにおいて、頑強なエッジとリアルタイムのフォグコンピューティング技術が不可欠となっていることがあります。このような超高耐性プラットフォームの典型的な使用例としては、24時間無停止が必須要件の鉄道や道路交通管制、スマートシティのインフラ、オフショア・リグや洋上風力発電所、配電ネットワーク、石油・ガス・水道等の配管システム、通信・放送ネットワーク、分散型監視やセキュリティシステムなどを挙げることができます。また、ネットワークに接続してIIoT / Industry 4.0を実現する産業用および医療用機器、屋外のキオスクやデジタルサイネージシステム、さらには自動運転配送車などの車載アプリケーションにも最適です。

コンガテックが提供する過酷な環境向けの新たなプラットフォームは、-40℃～+85℃の拡張温度範囲に対応し、BGAハンダ付の高耐衝撃・耐振動性と高EMI耐性を備えています。さらに、結露や塩水によるプラットフォームの腐食や、粉じんの侵入を防止するコンフォーマルコーティングのオプションも用意されています。

**拡張性の高い第11世代Intel®Core™プロセッサ搭載、最新のCOM-HPCおよびCOM Express**

プレゼンテーションのハイライトとなるのが、COM-HPC およびCOM Express規格に準拠し過酷な温度環境に対応するハイエンドのx86コンピュータ・オン・モジュール（CoM）です。conga-HPC/cTLU COM-HPC クライアントSize Aモジュールとconga-TC570 COM Express Compact モジュールは、拡張性の高い最新の第11世代Intel®Core™プロセッサで利用でき、-40℃～+85℃の拡張温度範囲に対応します。いずれのモジュールも、広帯域の周辺機器と接続するために、初めてGen 4性能でPCIe x4をサポートしています。

**Intel Atom® x6000Eシリーズプロセッサ搭載プラットフォーム**

Intel Atom® x6000E シリーズ、Intel® Celeron® およびPentium® N & J シリーズプロセッサを搭載し、-40°C to +85°Cの拡張温度範囲オプションを備えたコンガテックの頑強なプラットフォームは、SMARC、Qseven、COM Express Compact およびMiniフォームファクタ―、Pico-ITXシングル・ボード・コンピュータ（SBC）のコンピュータ・オン・モジュールで提供されます。これらは、特にリアルタイム性が重要な工業用領域で比類のない威力を発揮し、性能を向上させるだけでなく、タイムセンシティブ・ネットワーキング（TSN）、Intel®タイムコーディネーション・コンピューティング（Intel TCC）、Real-Time Systems社（RTS）のハイパーバイザのサポート、BIOS 設定可能なECCも提供します。

**i.MX 8M Plusプロセッサ搭載の最新のSMARC 2.1 CoM**

i.MX 8M Plusプロセッサを搭載した最新のSMARC 2.1 CoMを展示します。わずか2～6ワットの超低消費電力、拡張温度範囲対応の組込みおよびエッジコンピューティング向けプラットフォームは、4個の強力なArm Cortex-A53コアプロセッサにNeural Processing Unit（NPU）を加え、最大2.3TOPS のAI演算性能を実現します。エッジにおけるAI推論や機械学習向けに設計されたモジュールは、デュアルカメラのイメージシグナルプロセッサ（ISP）データの処理や分析用にも最適化され、2つのMIPI-CSIインタフェースを統合してデータを受けとります。

**すべての拡張温度範囲プラットフォームに含まれる広範なバリューパッケージ**

プラットフォームは、最も過酷な環境下でも常に安定した稼働を実現するために必要なあらゆる機能やサービスを提供します。バリューパッケージには頑強な受動冷却オプション、湿気や結露による腐食を防ぐコンフォーマルコーティングのオプション、推奨されるキャリアボード回路図のリストに加え、拡張温度範囲においても最高の信頼性を得るための専用コンポーネントが含まれます。こうした優れた技術的特長に加え、デザインインサービスやこれに付随する温度スクリーニング、高速信号コンプライアンス試験のサポート、コンガテックの組込みコンピュータ技術を簡単に利用するために必要なあらゆるトレーニングセッションなど、包括的なサービスが提供されます。

頑強なエッジおよびリアルタイムフォグコンピューティング用のコンガテックの拡張温度範囲対応製品の詳細については、オンラインで行われるembedded world 2021のコンガテックのブースをご訪問ください。<https://www.congatec.com/jp/congatec/events/embedded-world/>

voucher code **ew21456827 にて無料ご登録いただけます**

**##**

**コンガテックについて**コンガテックは、産業用組込みコンピューティングに特化したテクノロジーと製品で急速な成長を遂げている企業です。高性能コンピュータモジュールは、産業オートメーション、医療、輸送、通信、その他多くの業種のさまざまな用途やデバイスに対応しています。スタートアップからグローバル優良企業まで、優れた顧客基盤をもつコンピュータ・オン・モジュール分野のグローバルマーケットリーダです。2004年設立、ドイツのデッゲンドルフに本社を置き、2019年の売上高は1億2,600万ドルです。詳しくは、[当社ウェブサイト](https://www.congatec.com/jp/)、または[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449)、[Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG)、[YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE)をご覧ください。

\* IntelおよびCoreは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。

**■本製品に関するお問合せ先**

コンガテック ジャパン株式会社　担当：奥村

TEL: 03-6435-9250 Email: sales-jp@congatec.com

**■本リリースに関する報道関係者様からのお問合せ先**

コンガテック ジャパン株式会社　（同上） または

（広報代理）　プラップジャパン　高橋、谷本

Email: congatec@prap.co.jp